

46-1591 Economy Version

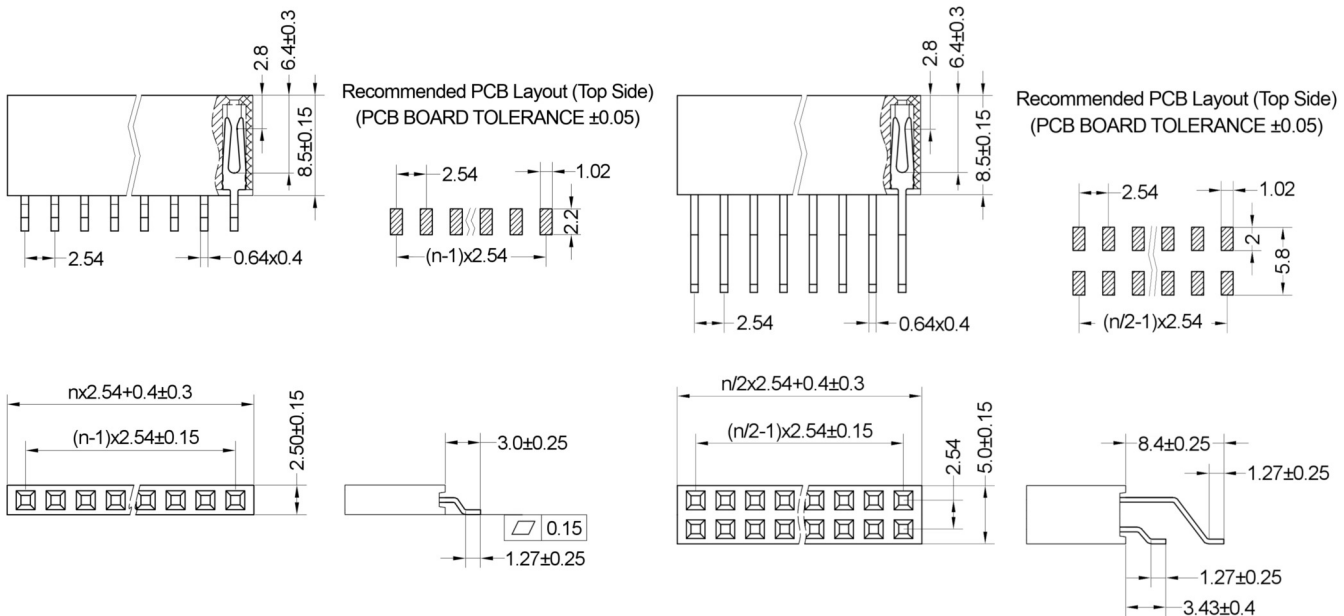
SMT-Buchsenleisten RM 2,54mm, liegend, 1-/2-reihig
SMT Female Headers, 2.54mm Pitch, Horizontal, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|--|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Kontaktfläche <i>Contact Surface</i> | Au über Ni <i>Au over Ni</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 1000 V AC/DC |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3 A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40 °C ... +105 °C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | 230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden) 230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds) |



Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.
Fork contacts accept 0.635mm square pins.



| | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| Series | Contacts* | Rows* | Plating | Packaging* |
| 46-1591 | 08 | 1 | 00 | ST |
| | 02-20 Einreihig Single row 06-40 Zweireihig Double row | 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row | 00 Vergoldet Gold plated | ST TR |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / Packed in tubes
TR Tape & Reel / Tape & Reel

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | untere Temperaturangabe [°C] |
| Verweildauer oberhalb T_L | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | obere Temperaturangabe [°C] |
| Dauer Höchsttemperatur | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | Lower Temperature [°C] |
| Duration above T_L | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | Upper Temperature [°C] |
| Duration Peak Temperature | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

